

图 1b BP1808A 典型应用电路(降压)

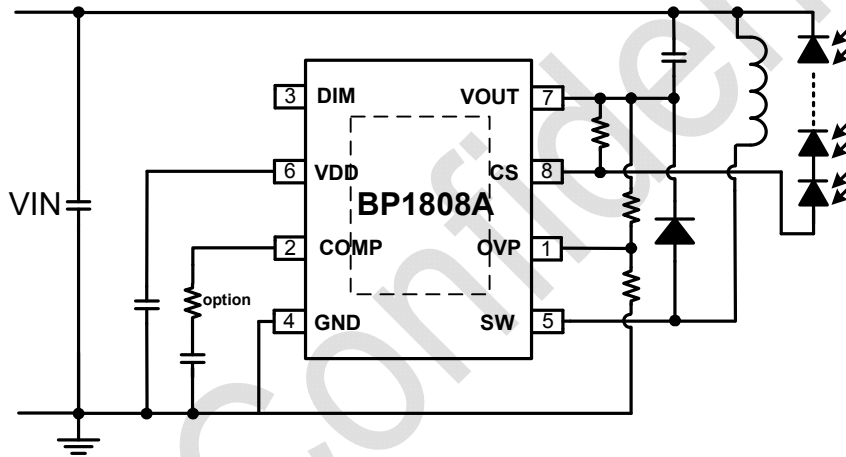
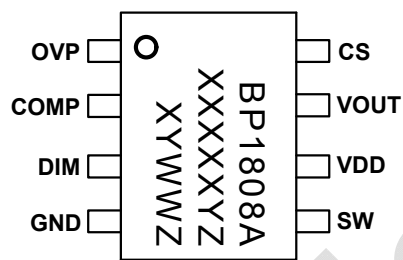


图 1c BP1808A 典型应用电路(升降压)

订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
BP1808A	ESOP-8	卷盘 4,000/盘	BP1808A XXXXXYZ XYWWZ

管脚封装



BP1808A: 产品型号
XXXXXY: 批次
XY: 标识
WW: 周号
Z: 预留

图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	OVP	过压保护端，连接至输出脚和地之间的分压电阻。
2	COMP	环路补偿端，连接补偿电阻（可选）串联补偿电容到地。
3	DIM	调光输入端，不调光时悬空。
4	GND	芯片地。
5	SW	开关端，连接内部 MOSFET 漏极及外部整流二极管阳极，保持 PCB 板上连线尽可能短。
6	VDD	芯片内部电源输出端，连接 1 μ F 旁路电容到地。
7	VOUT	输出电压连接点，并提供芯片电源
8	CS	LED 电流采样端，连接采样电阻到 VOUT 端。
9	散热焊盘	内部与芯片衬底连接，应用中可接地。

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。